

国内唯一のCOFメーカーフレキシード

FLEXCEED(株) (フレキシード、営業本部■東京都墨田区横網1-11-4、☎03-6658-5535)は、2015年7月に再スタートした日本で唯一のテープ・オートメーテッド・ボンディング(TAB)ならびにチップ・オン・フィルム(COF)の専門メーカーである。

その前身は、テープ・キャリア・パッケージング(TCP)のトップメーカーであった新藤電子工業だ。リーマン・ショックによって仕事量が急減するなか、12年3月に会社更生法を申請した。しかし、ジャフコ(東京都千代田区)の主導のもと、わずか1年で復活を果たす。13年には日立フレキシードという新社名は、自由な発想や考案方、柔軟な対応力の「フレキシブル」と、卓越した開発力の「エクス」の造語として名付けられた。15年7月1日に現社名に改め、16年7

担当する。さらに、より高密度・小型化が要求されるメダイカル機器やウェアラブル機器、ワイヤレス給電用途向けに2メタル(2層配線)のCOF/TAB基板ニーズも出てきているとして、関連製品の量産化技術も磨く。

直近では、高輝度LED

同社ではこの細線化プロセスについて、SAP(セミアディティブプロセス)ではなくエッチング工法のサブトラクティブ(サートラ)工法で製造する。すでに指紋センサーモジュール用途でノートPC向けに量産中だ。さらにはウェアラブル機器向けにも開発を加速する。既存のものでは4層リジッド基板を採用しているが、これを2層メタルCOFで代替する。

モジュール化製品をはじめメダイカル機器向け、生体センサーなど幅広い用途に向けて引き合

■市況好調でフル稼働に足元の市況は、16年初めから好調が続く。4K用途など高解像度の大型テレビ向けドライバーを必要とするCOF需要が立ち上がり、現在は土日の出勤増で対応するほどの繁忙状態が続く。受注量は前年同期比で20%増の勢いだ。

COF基板の需要は現在、2つの大きなトレンドがあるとしている。IoT・メダイカル向けに加えて、省エネ・産業機器用途での展開だ。前者では薄銅箔を基本に超フ

エッチングで16μmピッチに挑戦

電線のパッケージ材料事業を譲り受け、国内唯一のTAB/COF専門メーカーとなった。14年には、旧本社でマザー工場と

■次世代技術開発の拠点、助川工場

助川工場の役目は、TCP/COFの技術開発や一部の先端製品の量産を手がけるが、研究開発が中心になる。旧日立電線の拠点工場の1つで、現在は2層TABの量産なども行う。このほかネ

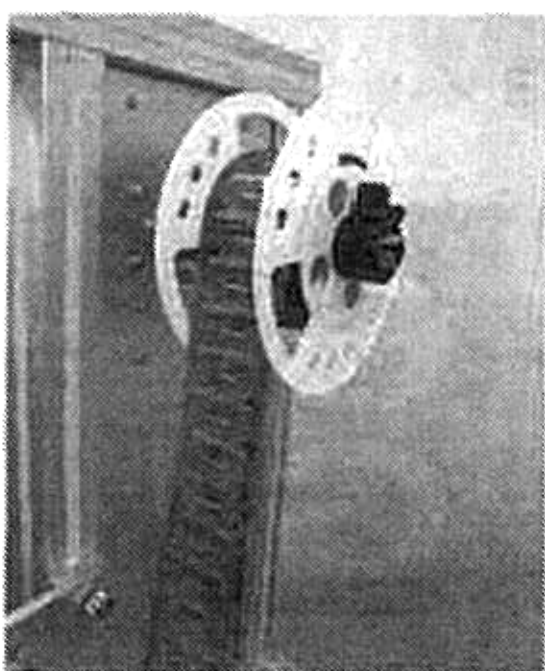
■2層メタル・20μmピッチ化も

今後はCOFの2層メタル製品のラインアップに切り替わるケースもあるという。接合方法がWB(ワイヤーボンディング)からFC(フリック)からFIC(フリック)に切り替わるタイミングでの基材変更もあり、市場は確実に広がっているようだ。

理由は、ポリイミドベ

すでに超ファインピッチのCOFの検査も可能なAOI(外観検査装置)や洗浄装置を量産拠点の那珂工場には導入済みで、将来のファインピッチ化需要に対応する。16年3月期は約60億円の売り上げを確保したが、足元の好調を受けて17年3月期には約80億円に引き上げる。

(副編集長 野村和広)



COFの製品例

・集約した。珂工場に移設

理由は、ポリイミドベ

■市況好調でフル稼働に足元の市況は、16年初めから好調が続く。4K用途など高解像度の大型テレビ向けドライバーを必要とするCOF需要が立ち上がり、現在は土日の出勤増で対応するほどの繁忙状態が続く。受注量は前年同期比で20%増の勢いだ。

COF基板の需要は現在、2つの大きなトレンドがあるとしている。IoT・メダイカル向けに加えて、省エネ・産業機器用途での展開だ。前者では薄銅箔を基本に超フ

すでに超ファインピッチのCOFの検査も可能なAOI(外観検査装置)や洗浄装置を量産拠点の那珂工場には導入済みで、将来のファインピッチ化需要に対応する。16年3月期は約60億円の売り上げを確保したが、足元の好調を受けて17年3月期には約80億円に引き上げる。

(副編集長 野村和広)